

半導體補助政策：軍備競賽常態化

基於半導體的通用性與重要性，半導體被認為是21世紀的「新石油」。在2019年半導體供應鏈斷鏈，地緣政治影響貿易全球化發展後，財團法人資訊工業策進會科技法律研究所觀察發現，各國逐漸意識到過度依賴外國半導體先進製程工廠可能會對自身國家安全帶來危機。

為解決上述問題，各國皆紛紛頒布半導體補助政策來吸引晶圓代工廠商或半導體製造廠商於國內新建半導體工廠，以緩解供應鏈斷鏈與地緣政治帶來的影響，同時加強供應鏈韌性。例如美國於2022年8月9日發布《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act），提供527億美元（約1兆6千億台幣）的半導體製造補貼；歐盟於2023年4月18日通過《歐盟晶片法案》（EU Chips Act）政治協議，預計提供430億歐元（約1兆4千億台幣）的半導體製造補貼；英國也於2023年5月19日發布「國家半導體戰略」（The National Semiconductor Strategy），計畫將在未來10年內提供半導體製造業及研發單位10億英鎊（約380億台幣）的援助。

臺灣亦於民國112年1月19日修正通過《產業創新條例》第10-2條，並於同年5月1日預告本條子法，為國內進行技術創新、且居國際供應鏈關鍵地位的公司，研究發展投資達60億元台幣及符合相關適用條件者，提供25%的前瞻創新研發抵稅優惠及5%的先進製程設備購入抵稅優惠。雖然本條並未明文針對特定產業，然基於上述國際趨勢，多數人將本條稱為「台股晶片法」，顯見此為臺灣應對外國補助政策的其中一個手段。



各國半導體補助政策

英國		<ul style="list-style-type: none">2023年至2025年提供半導體產業2億英鎊之補助預計於2033年前提供半導體產業總額達10億英鎊之補助
歐盟		<ul style="list-style-type: none">歐盟於2023年4月18日宣布通過《歐洲晶片法案》之政治協議，將加速通過其立法，計畫於2030年前結合政府與私人投資達430億歐元
日本		<ul style="list-style-type: none">修正後《半導體援助法》於2022年3月1日施行，將補助半導體設備50%之費用支出日本政府 and 八大企業合作於2022年8月投資成立Rapidus半導體公司，計畫在日本當地生產2奈米晶片
中國		<ul style="list-style-type: none">2020年1月1日起，28奈米以下製程之半導體廠免稅10年；2014年成立〈國家集成電路產業投資基金〉（俗稱大基金）二期共3,400億人民幣；預計於2023年起提供超過1兆人民幣的半導體生產補助
美國		<ul style="list-style-type: none">美國總統於2022年8月9日簽署《晶片與科學法》，將為半導體製造業於2027年前提供總額高達527億美元之補助，及為建設新廠房之投資提供25%的租稅優惠
台灣		<ul style="list-style-type: none">《產業創新條例》於2023年1月7日三讀通過增訂第10-2條，提供半導體前瞻創新研發支出（25%）及先進製程設備支出（5%）之租稅優惠

資料來源：經濟日報、遠見雜誌、Bloomberg、The Korea Herald、Reuters、European Commission及美國白宮

0

2023 © 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

圖一：各國半導體補助政策。

然而，除了同樣採行補助政策回應國際趨勢外，資策會科法所法律研究員吳彬詣表示，根據美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）的預估，建立一個完整的半導體生態系統需花費至少超過1兆美元（約30兆台幣），若涉及先進製程，費用可能會更高。由此可知，各國政府想單獨利用補助從零開始建造一個完整的半導體供應鏈實屬不易。因此，臺灣無須過度擔心半導體製造、封裝等產業優勢受其他國家補助政策影響，應專注提升臺灣與他國間的技術差距，而《產業創新條例》第10-2條提供的25%的前瞻創新研發抵稅優惠，或許得以協助臺灣達成該目的，繼續擴大臺灣半導體產業技術領先優勢。

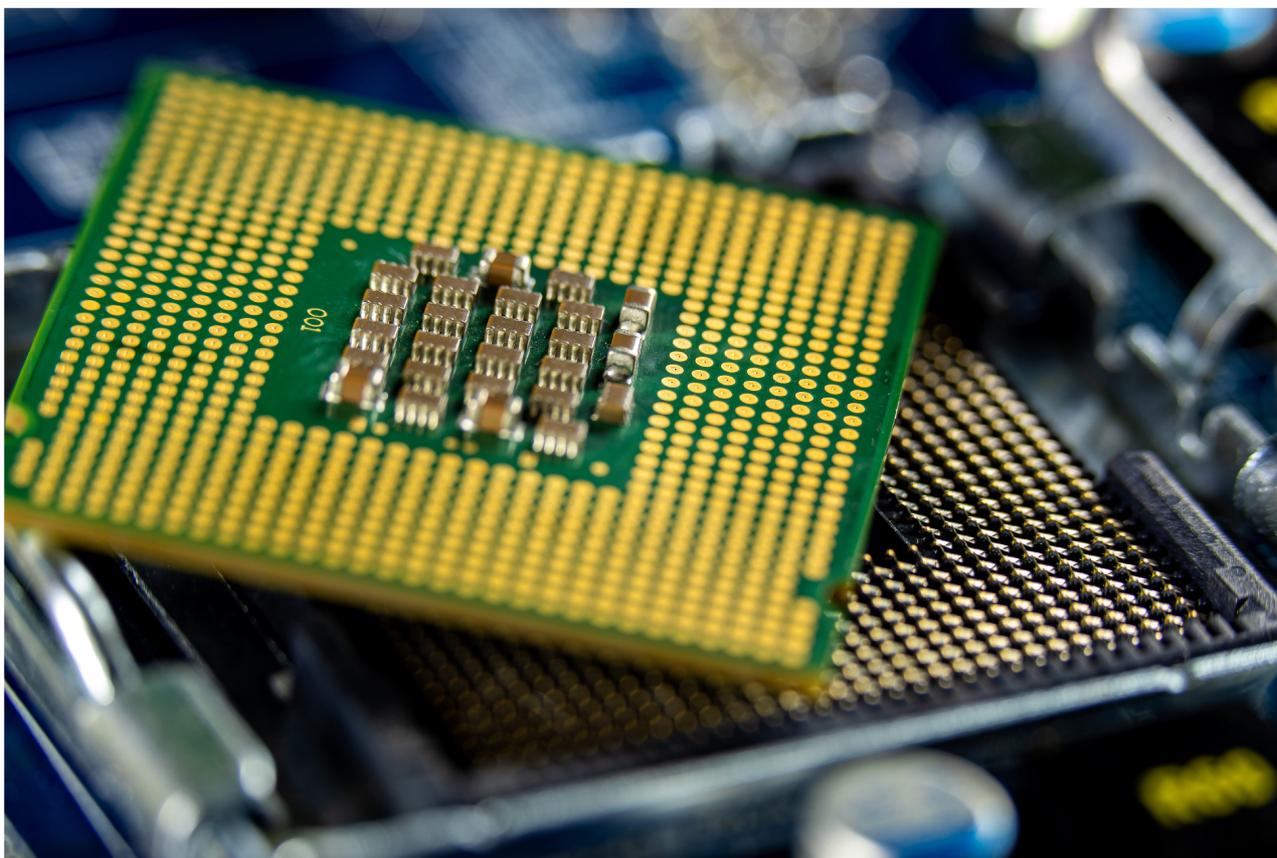


Photo by Sergei Starostin: <https://www.pexels.com/photo/central-processor-of-a-computer-5526462/>

圖二：半導體示意圖。



上稿時間：2023年05月30日

新聞來源：<https://www.cna.com.tw/postwrite/chi/342776>

文章標籤